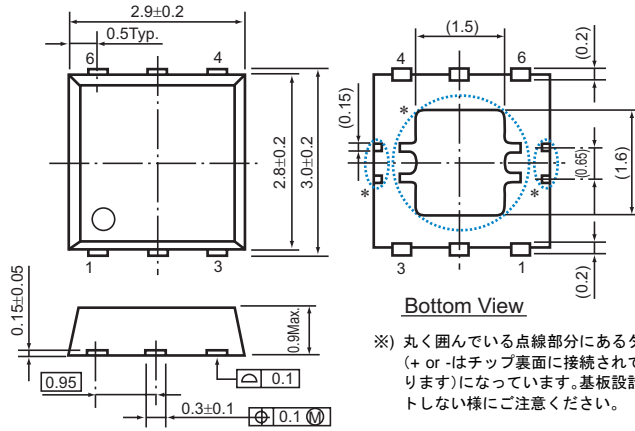


HSON-6

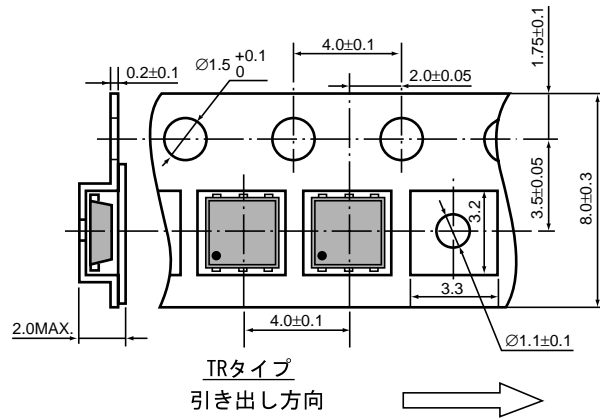
単位:mm

■ パッケージ外形図



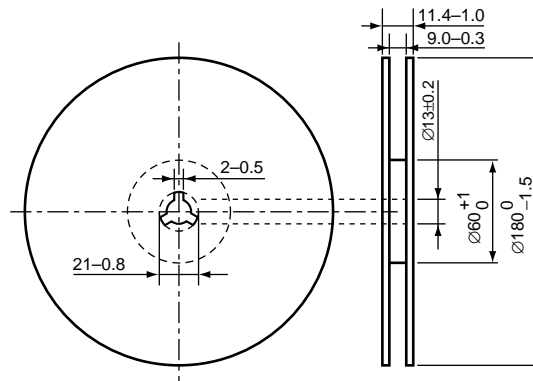
※) 丸く囲んでいる点線部分にあるタブ吊りリードは電源電位 (+ or -はチップ裏面に接続されている為、製品により異なります) になっています。基板設計の際に他の配線とショートしない様にご注意ください。

■ テーピング仕様



■ テーピングリール外形図 リュースリール(EIAJ-RRM-08Bc)

(1リール=3000個)



### ■ 許容損失について (HSON-6)

HSON-6パッケージの許容損失について特性例を示します。

なお、許容損失は実装条件に左右されますので、本特性例は下記測定条件での参考データとなります。

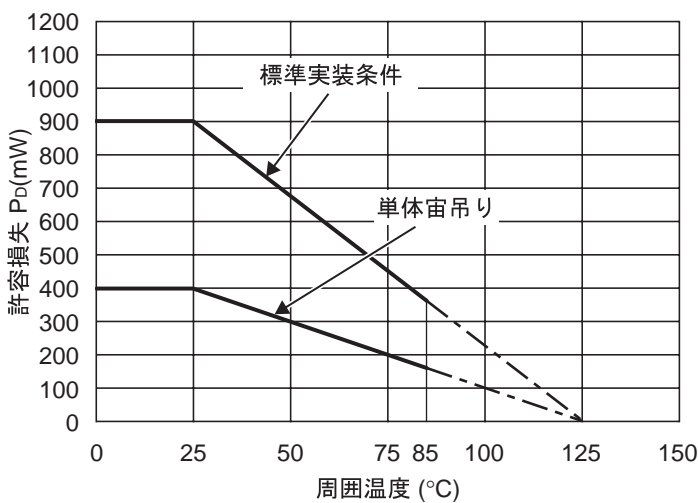
測定条件

	標準実装条件
測定状態	基板実装状態 (風速 0m/s)
基板材質	ガラスエポキシ樹脂 (両面基板)
基板サイズ	40mm × 40mm × 1.6mm
配線率	表面 約 50%、裏面 約 50%
スルーホール	直径 0.5mm × 44 個

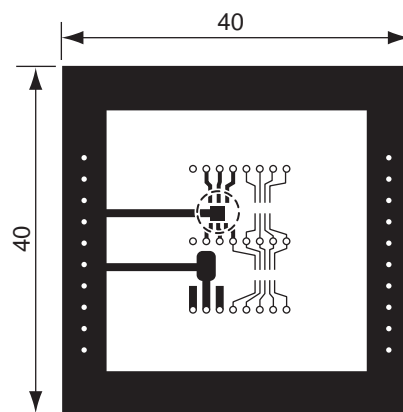
測定結果

(T<sub>opt</sub>=25°C, T<sub>jmax</sub>=125°C)

	標準実装条件	単体宙吊り
許容損失	900mW	400mW
熱抵抗値	$\theta_{ja} = (125-25^\circ\text{C})/0.9\text{W} = 111^\circ\text{C/W}$	250°C/W
		$\theta_{jc} = 43.5^\circ\text{C/W}$



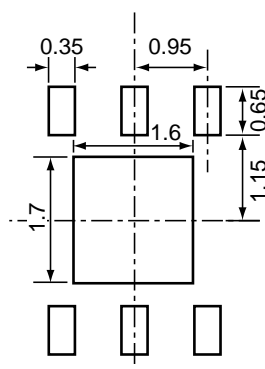
許容損失特性例



測定用基板レイアウト

○ IC 実装位置 (単位 : mm)

### ■ 基板パッド推奨寸法 (HSON-6)



(単位 : mm)